证券代码: 002516 证券简称: 旷达科技 公告编号: 2022-025

旷达科技集团股份有限公司关于下属公司 投资进展暨参股公司对相关公司第二次增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司")下属公司的参股公司芯投微电子科技(上海)有限公司(以下简称"芯投微")于2020年10月30日完成对NDK SAW devices Co., Ltd.(以下简称"NSD")第一批次51%股权的交割程序;并于2020年11月4日与NSD的另一股东Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.(以下简称"NDK")按股权比例完成同比例增资。

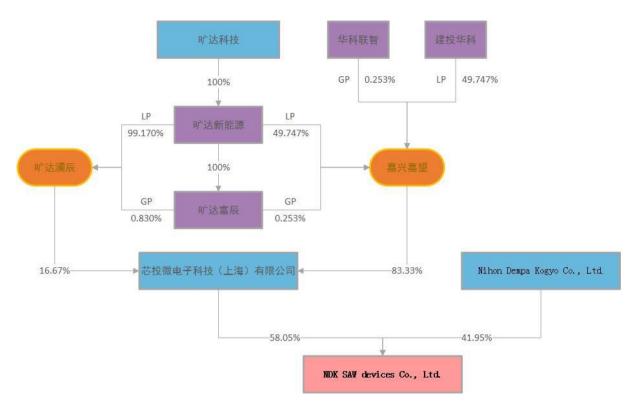
二、进展情况

受疫情影响及综合考虑 NSD 的稳定发展,芯投微与 NDK 对双方于 2020 年 6 月 3 日签订的 Share Purchase Agreement ("SPA")及 Joint Venture Agreement ("JVA")中约定的有关第二次股权交割事项进行了延期。为支持并加快 NSD 扩产和研发进程,双方对 SPA 和 JVA 进行了补充,由芯投微对 NSD 单方增资,并签订了增资协议。双方约定由芯投微以每股 69 万日元的价格,认购 NSD 新增的 2,032 股,芯投微对 NSD 的持股比例增加至 58.05%。NDK 不参与本次增资。

近日,芯投微完成了本次增资款缴纳并办理 NSD 的工商变更。具体认购情况:

股东	新增认购股份数量 (株)	认购金额 (万日元)	新增注资后的 持股数额(股)	新增注资后的 股份比例
NDK	0	-	5, 929	41.95%
芯投微	2, 032	140, 208	8, 203	58.05%
合计	2, 032	140, 208	14, 132	100%

本次增资完成,各投资方的股权结构图如下:



三、其他

根据芯投微与 NDK 于 2020 年 6 月 3 日签订的 SPA 及 JVA, 双方在本次增资后将继续推进芯投微对 NSD 股权提升的事项,完成最终芯投微持有 NSD75%的股权。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会 2022年6月29日